

# 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月5日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。会议补充通知已于2024年12月9日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，预计2025年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过8,100万元的日常关联交易；同时，公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，预计与上海新朋实业股份有限公司每个年度发生总额不超过1,440万元的日常关联交易。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事吴华回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》**

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，公司拟以自有资金 500 万元认购鑫益邦半导体（江苏）有限公司（以下简称“鑫益邦”）新增注册资本 67.3077 万元，本次增资完成后，公司将持有鑫益邦 3.2258% 的股权。同时，南通金泰科技有限公司（以下简称“南通金泰”）拟以 800 万元认购鑫益邦新增注册资本 107.6923 万元。

南通金泰系持有公司 5% 以上股份的法人股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通金泰为公司关联法人；此外，公司董事吴华先生系鑫益邦法定代表人及执行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，鑫益邦为公司关联法人，公司本次认购鑫益邦部分新增注册资本构成关联交易。

本次投资对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。

同时，授权公司管理层办理公司本次认购鑫益邦新增注册资本的相关具体事宜，包括但不限于相关协议、文件的签署等工作。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事吴华回避表决）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

## **（三）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》**

为满足公司发展计划和战略实施的需要，2025 年度公司拟向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 3 亿元（包括 3 亿元）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），期限为 12 个月。上述额度在授权期限内可以循环使用，公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、反担保、抵押、包含融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

公司实际控制人崔学峰、龙波先生等关联自然人拟根据实际需要为公司上述申

请银行综合授信额度等相关事项提供担保、反担保，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

#### （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日